

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年2月6日(06.02.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/026732 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 23/58 (2006.01) *G01K 1/18* (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01) *H05K 7/06* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/027277

(22) 国際出願日: 2019年7月10日(10.07.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-144347 2018年7月31日(31.07.2018) JP

(71) 出願人: 株式会社オートネットワーク技術
研究所(AUTONETWORKS TECHNOLOGIES,
LTD.) [JP/JP]; 〒5108503 三重県四日市市西
末広町1番14号 Mie (JP). 住友電装株式

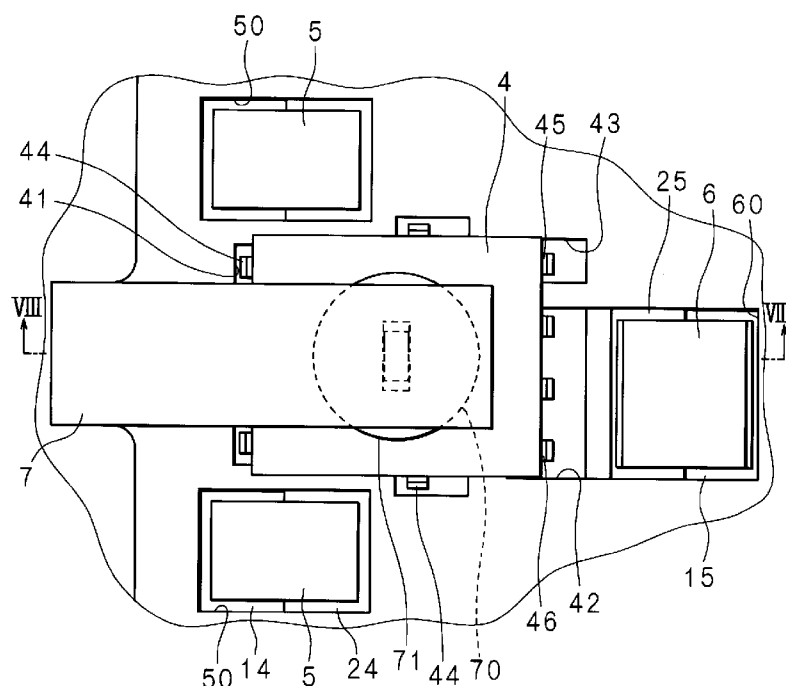
会社(SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.)
[JP/JP]; 〒5108503 三重県四日市市西末広
町1番14号 Mie (JP). 住友電気工業株
式会社(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,
LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区
北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).

(72) 発明者: 原 口 章 (HARAGUCHI, Akira);
〒5108503 三重県四日市市西末広町1番
14号 株式会社オートネットワーク
技術研究所内 Mie (JP).

(74) 代理人: 河野 英仁, 外(KOHN, Hideto et al.);
〒5400035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目
4番3号 河野特許事務所 Osaka (JP).

(54) Title: CIRCUIT STRUCTURE

(54) 発明の名称: 回路構成体



(57) Abstract: A circuit structure comprising a circuit board, a switching element mounted on one surface of the circuit board, a folded section extending from a peripheral section of the circuit board and folded back to the one surface side, and a temperature measuring instrument mounted on the folded section and in contact with the switching element.

(57) 要約: 回路基板と、該回路基板の一面に実装されているスイッチング素子と、前記回路基板の周縁部から延出し、前記一面側に折返している折返し部と、該折返し部に実装され、前記スイッチング素子に接触している温度測定器とを備える回路構成体。

[続葉有]



WO 2020/026732 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

明 細 書

発明の名称：回路構成体

技術分野

[0001] 本発明は、回路構成体に関する。

本出願は、2018年7月31日出願の日本出願第2018-144347号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。

背景技術

[0002] 従来、車両における電源及び負荷の間に、電源から負荷への電力供給に係る通電の制御を行う回路構成体が搭載されている。回路構成体は、スイッチング素子を備え、スイッチング素子のオンオフを制御する制御回路を更に備える。スイッチング素子は、制御回路から入力される信号に基づいてオンオフする。回路構成体は、スイッチング素子のオンオフにより上記通電の制御を行う。

[0003] スwitchング素子は過熱による不安定な動作及び故障等を防止するため、温度測定器によりスイッチング素子の温度を測定する場合がある。特許文献1においては、温度測定器（サーミスタ）及びスイッチング素子（パワーMOSFET）を同一の回路基板上に実装し、温度測定対象であるスイッチング素子を取り付ける導電部（ランド）と、温度検出器（温度検出素子）が接続される導電部とを一体的に回路基板に形成している。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2006-237144号公報

発明の概要

[0005] 本発明の一態様に係る回路構成体は、回路基板と、該回路基板の一面に実装されているスイッチング素子と、前記回路基板の周縁部から延出し、前記一面側に折返している折返し部と、該折返し部に実装され、前記スイッチン

グ素子に接触している温度測定器とを備える回路構成体。

図面の簡単な説明

- [0006] [図1]図1は実施の形態に係る回路構成体の外観斜視図である。
- [図2]図2は蓋部を取り外した状態を示す回路構成体の斜視図である。
- [図3]図3はF E Tの搭載態様を示す斜視図である。
- [図4]図4は回路基板を載置していない状態を示す斜視図である。
- [図5]図5はF E Tの搭載を説明する斜視図である。
- [図6]図6は第1導電部及び第2導電部を示す部分拡大平面図である。
- [図7]図7はサーミスタの搭載態様を示す部分拡大平面図である。
- [図8]図8は図7のV I I I - V I I I線による断面図である。

発明を実施するための形態

- [0007] [本開示が解決しようとする課題]

回路構成体において熱容量の大きい放熱器を使用する場合があり、この場合、特許文献1の技術ではスイッチング素子からの回路基板への熱の伝導が弱くなり、温度検出器の周囲温度が上昇せず、スイッチング素子の温度を良好に測定できず、異常な発熱を良好に検出できない虞がある。

- [0008] 本発明の目的は、良好にスイッチング素子の温度を測定することができる回路構成体を提供することにある。

[本開示の効果]

- [0009] 上記によれば、良好にスイッチング素子の温度を測定することができる。
- [0010] 本発明の実施態様を列記して説明する。また、以下に記載する実施形態の少なくとも一部を任意に組み合わせても良い。
- [0011] 本発明の一態様に係る回路構成体は、回路基板と、該回路基板の一面に実装されているスイッチング素子と、前記回路基板の周縁部から延出し、前記一面側に折返している折返し部と、該折返し部に実装され、前記スイッチング素子に接触している温度測定器とを備える回路構成体。
- [0012] 本態様にあつては、温度測定器及びスイッチング素子との距離が近くなり、良好にスイッチング素子の温度を測定することができる。

[0013] 本発明の一態様に係る回路構成体は、前記スイッチング素子、折返し部及び温度測定器は夫々複数ある。

[0014] 本態様にあっては、複数のスイッチング素子の温度を各別に測定することができる。

[0015] 本発明の一態様に係る回路構成体は、前記温度測定器及びスイッチング素子間には固着部が設けられている。

[0016] 本態様にあっては、また、温度測定器を固着部に良好に固定することができる。

[0017] 本発明の一態様に係る回路構成体は、前記固着部は熱硬化性である。

[0018] 本態様にあっては、熱硬化前の固着部に温度測定器を埋め込んだ後熱硬化することにより、温度測定器を良好に固着部に固定することができる。

[0019] 本発明の一態様に係る回路構成体は、前記回路基板の他面に対向し、電力が入力される入力側バスバーと、前記回路基板の他面に対向し、電力が出力される出力側バスバーと前記回路基板に設けられ、前記スイッチング素子の入力端子及び出力端子夫々を前記入力側バスバー及び出力側バスバーに接続する導電部とを備える。

[0020] 本態様にあっては、入力側バスバーから入力され出力側バスバーから出力される電力を、スイッチング素子によりオンオフすることができる。

[0021] 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。

図1は実施の形態に係る回路構成体の外観斜視図である。回路構成体1は、車両が備えるバッテリー等の電源と、ランプ、ワイパ又はモータ等の負荷との間の電力供給経路に配される。

[0022] 回路構成体1は、筐体10を備える。筐体10は直方体状をなし、矩形平板状の本体部10a及び該本体部10aの一面を全面に亘って覆う蓋部10bを有する。

[0023] 図2は、蓋部10bを取り外した状態を示す回路構成体の斜視図である。回路構成体1は、回路基板2及び制御基板3を備える。回路基板2は例えば、FPC (Flexible Printed Circuits) 等である。回路基板2は、一面を本

体部 10a に対向させて載置されている。回路基板 2 は、後述する FET (Field Effect Transistor) 及び導電片等の電子部品が実装されている。

[0024] 制御基板 3 は、矩形板状をなし、一面が回路基板に対向し、長手方向が回路基板 2 の長手方向に沿うように配されている。制御基板 3 の一面には、抵抗、コイル、コンデンサ、ダイオード等の電子部品と、これらの電子部品を電氣的に接続する配線パターンとを含む制御回路（不図示）が設けられている。

[0025] 回路基板 2 の一の短辺部には、棒状の接続コネクタ 11 が立設されている。回路基板 2 は、接続コネクタ 11 を介して制御基板 3 に接続されている。

[0026] コネクタ 12 は、外形が筒状をなし、コネクタ 12 の内部には複数の棒状の端子部 12a が設けられている。端子部 12a の一端部が外部に設けられた ECU (Electronic Control Unit) に信号線（不図示）を介して接続される。コネクタ 12 における各端子部 12a の他端部は、制御基板 3 の配線パターンに接続されている。コネクタ 12 は、蓋部 10b を本体部 10a に取り付けた場合、図 1 に示すように蓋部 10b から突出している。

[0027] 図 3 は、FET の搭載態様を示す斜視図である。回路構成体 1 は、複数の FET 4（図では 6 個）と、複数の第 1 導電片 5（図では 8 枚）と、複数の第 2 導電片 6（図では 6 枚）を備える。なお、FET 4、第 1 導電片 5 及び第 2 導電片 6 は図示の個数に限られない。

[0028] FET 4 は、回路基板 2 の他面において、前記一の短辺部の反対側の他の短辺部に沿って 2 個配されており、一の長辺部に沿って 4 個並設されている。回路基板 2 の一の短辺部には接続コネクタ 11 が接続される複数のスルーホール 22 が並設されている。

[0029] 第 1 導電片 5 は、各 FET 4 を挟むように配されており、回路基板 2 の他の短辺部に沿って 3 個、一の長辺部に沿って 5 個配されている。第 2 導電片 6 は、回路基板 2 の他の短辺部に沿って 2 個、一の長辺部に沿って 4 個配されている。第 2 導電片 6 は夫々、FET 4 夫々に対応させて設けられており、FET 4 よりも内側に位置している。第 2 導電片 6 の周囲には、複数のチ

ップ部品が配されている。第1導電片5及び第2導電片6は、導電性及び熱伝導性に優れた銅製のチップが好ましい。

[0030] 図4は、回路基板2を載置していない状態を示す斜視図である。図5は、FET4の搭載を説明する斜視図である。図6は、第1導電部及び第2導電部を示す部分拡大平面図である。

[0031] 図4に示すように、本体部10aの一面には、板状の入力側バスバー14及び出力側バスバー15が面に設けられている。入力側バスバー14は平面視L字状をなし、L字の直線部分夫々が本体部10aの長辺部及び短辺部に沿うように位置している。入力側バスバー14の一端部には入力端子部14aが連続して設けられ、本体部10aから突出している。

[0032] 出力側バスバー15は矩形状をなし、本体部10aの一面の中央部に配されている。出力側バスバー15は、長手方向が本体部10aの長手方向に沿うように、入力側バスバー14と所定距離離隔させて配されている。出力側バスバー15において、入力側バスバー14の長辺の中央部には出力端子部15aが連続して設けられ、本体部10aから突出している。

[0033] 入力側バスバー14及び出力側バスバー15、入力端子部14a及び出力端子部15aは、例えば、板厚2mmで、表面にニッケルめっきを施したバスバー部材により形成される。

[0034] 入力端子部14a及び出力端子部15aには夫々、厚さ方向に貫通する貫通孔14b、15bが設けられ、貫通孔14b、15bに挿通されたボルト（不図示）により、電源及び負荷に接続される。入力端子部14aが電源側に接続され、出力端子部15aが負荷側に接続される。

[0035] 本体部10aは、例えばフェノール樹脂、ガラスエポキシ樹脂などの絶縁性樹脂材料を用いたインサート成形により製造される。絶縁性樹脂材料により成形される樹脂成形体は、入力端子部14a、出力端子部15a、入力側バスバー14、及び出力側バスバー15と接合されることによって、これらを一体化する。また、樹脂成形体は、入力端子部14a及び出力端子部15a間と、入力側バスバー14及び出力側バスバー15間とに配されることに

よって、これらの間を絶縁する。

[0036] また、回路基板 2 は、図 4 に示すように矩形状の熱伝導性が高く、絶縁性の粘着性シート 2 1 により本体部 1 0 a に接着されている。

[0037] 回路基板 2 には、各 F E T 4 に対応する位置に、第 1 開口部 4 1、第 2 開口部 4 2、第 3 開口部 4 3 が貫設されている。第 2 開口部 4 2 及び第 3 開口部 4 3 は、回路基板 2 において、第 1 開口部 4 1 よりも内側に位置し、長手方向又は短手方向に沿って並んでいる。第 1 開口部 4 1 は第 2 開口部 4 2 及び第 3 開口部 4 3 よりも大きく、第 2 開口部 4 2 は第 3 開口部 4 3 よりも大きい。

[0038] また、回路基板 2 には、各第 1 導電片 5 に対応する位置に第 4 開口部 5 0 が貫設されている。更に、各第 2 導電片 6 に対応する位置に第 5 開口部 6 0 が貫設されている。第 5 開口部 6 0 は、第 1 開口部 4 1 とで第 2 開口部 4 2 を挟むように位置している。

[0039] 回路基板 2 の一面において、第 1 開口部 4 1、第 4 開口部 5 0 に対応する位置に矩形状の第 1 導電部 2 4 が設けられている。第 1 導電部 2 4 は、第 1 開口部 4 1 の全体から他面側に露出しており、第 4 開口部 5 0 の内側半分において他面側に露出している。なお、第 1 導電部は、上記のように露出していれば、全ての第 1 開口部 4 1 及び第 4 開口部 5 0 に対応するように L 字状に設けられてもよく、又は第 1 開口部 4 1 及び第 4 開口部 5 0 毎に設けられていてもよい。

[0040] 第 2 開口部 4 2 及び第 5 開口部 6 0 に対応する位置に矩形状の第 2 導電部 2 5 が設けられている。第 2 導電部 2 5 は、第 2 開口部 4 2 全体から他面側に露出し、第 5 開口部 6 0 の外側半分から他面側に露出している。更に、回路基板 2 の一面において、第 3 開口部 4 3 に対応する位置にはランド部 2 6 が設けられ、第 3 開口部 4 3 全体から他面側に露出している。また、回路基板 2 の一面には、ランド部 2 6 及びスルーホール 2 2 を電氣的に接続する接続部 2 2 a が設けられている。第 1 導電部 2 4、第 2 導電部 2 5、ランド部 2 6、接続部 2 2 a は例えば、銅箔により形成されている。

- [0041] 粘着性シート21には、回路基板2の第4開口部50及び第5開口部60に対応する位置に、第1孔210及び第2孔211が貫設されている。第1孔210は第4開口部50の外側半分に对应し、第2孔211は第5開口部60の内側半分に对应している。
- [0042] 回路基板2及び粘着性シート21は、第1導電部24、第2導電部25、ランド部26、接続部22aを含む回路基板2の回路パターンが形成されている一面が粘着性シート21側に位置するように、本体部10aの一面に重ねて配されている。第1孔210は第4開口部50に連なり、かつ第1導電部24に重なっていない。また、第2孔211は、第5開口部60に連なり、第2導電部25に重なっていない。
- [0043] 図6に示すように、第4開口部50及び第1孔210からは入力側バスバー14の一部が露出し、第5開口部60及び第2孔211からは出力側バスバー15の一部が露出している。
- [0044] 回路基板2は例えばポリイミドをベース部材として、各導電部等を含むパターンを一面にてエッチング加工により形成し、絶縁性のカバーフィルムを貼り付けたものが使用される。第1導電部24、第2導電部25、ランド部26、接続部22aとしては例えば35 μ mの銅箔が使用される。また、各導電片は例えば0.2mm~0.5mmの純銅製又は銅合金製であり、表面をスズ、ニッケル等によりめっき処理したものが使用される。
- [0045] 図7は、サーミスタ70の搭載態様を示す部分拡大平面図である。図8は、図7のVⅠⅠⅠ-VⅠⅠⅠ線による断面図である。
- [0046] FET4は、直方体状をなしており、一の側面及び該一の側面に連なる二つの側面から突出している4つのドレイン端子44と、前記一の側面の反対側の側面から突出している1つのゲート端子45及び3つのソース端子46とを備える。
- [0047] FET4は第1開口部41~第3開口部43に跨るように配されている。各ドレイン端子44は第1開口部41において第1導電部24にはんだ付けされ、ゲート端子45は第3開口部43においてランド部26にはんだ付け

され、ソース端子 4 6 は第 2 開口部 4 2 において第 2 導電部 2 5 にはんだ付けされている。

[0048] 第 1 導電片 5 は第 4 開口部 5 0 において、入力側バスバー 1 4 及び第 1 導電部 2 4 に跨るように配され、これらにはんだにより接続されている。第 2 導電片 6 は第 5 開口部 6 0 において、出力側バスバー 1 5 及び第 2 導電部 2 5 に跨るように配され、これらにはんだにより接続されている。

[0049] F E T 4、第 1 導電片 5 及び第 2 導電片 6 が接続される第 1 導電部 2 4 及び第 2 導電部 2 5 には、例えば、はんだペーストを塗布し、これらを配置してリフローはんだ付けを行うことにより実装される。

[0050] ここで、粘着性シート 2 1 は例えば熱伝導性フィラを含有し、アクリル系又はシリコン系等の高耐熱性の粘着剤が使用されたシートが好ましい。これにより、F E T 4 の発熱による熱をバスバー側に伝導して放熱でき、また、リフロー時の粘着性シート 2 1 の耐熱性を向上できる。

[0051] 回路基板 2 には、各第 1 開口部 4 1 に対応する位置に折返し部 7 が設けられている。折返し部 7 の延出端部には、サーミスタ 7 0 が取り付けられている。折返し部 7 は、回路基板 2 の短辺部又は長辺部から垂直に延出し、延出端部が各 F E T 4 に当接するように折り曲げられている。図 4 ～図 5 は、折返し部 7 が折返される前の状態を示す。

[0052] サーミスタ 7 0 により、各 F E T 4 の温度を個別に測定することができる。サーミスタ 7 0 は、回路基板 2 の銅箔により形成されている回路パターン（不図示）を介してスルーホール 2 2 に接続されている。なお、サーミスタ 7 0 は温度測定器の一例であり、サーミスタ 7 0 に代えて半導体温度センサ等その他の温度測定器を使用してもよい。

[0053] また、回路基板 2 の折返し部 7 は F E T 4 の取り付け後、基端部側において折り曲げられており、延出端部が F E T 4 の天面に当接している。折返し部 7 の延出端部に設けられたサーミスタ 7 0 は、折返し部 7 及び F E T 4 に挟まれており、折返し部 7 及び F E T 4 間に位置する固着部 7 1 に埋設することにより F E T 4 の天面に固定されている。

- [0054] 固着部 7 1 は、例えば熱伝導性フィラを含有した熱硬化性のシリコン組成物により形成される。F E T 4 の天面に熱硬化前のゲル状の固着部 7 1 を F E T 4 に塗布し、折返し部 7 を折り曲げてサーミスタ 7 0 を固着部 7 1 に埋め込む。その後、固着部 7 1 を熱硬化させることによりサーミスタ 7 0 が F E T 4 に固定される。
- [0055] 以上の構成により、F E T 4 のゲート端子 4 5 は、ランド部 2 6、接続部 2 2 a、スルーホール 2 2、接続コネクタ 1 1 を介して制御基板 3 に接続されている。これにより、外部の E C U からの信号に基づく制御基板 3 からの信号が F E T 4 に入力される。制御基板 3 からの信号によって、F E T 4 のオンオフが切り替えられる。ゲート端子 4 5 に所定の電圧が印加されることにより、ドレイン端子 4 4 及びソース端子 4 6 が導通し、F E T 4 がオンになる。
- [0056] また、F E T 4 のドレイン端子 4 4 は、第 1 導電部 2 4、第 1 導電片 5 を介して入力側バスバー 1 4 に接続されている。F E T 4 のソース端子 4 6 は、第 2 導電部 2 5 及び第 2 導電片 6 を介して出力側バスバー 1 5 に接続されている。
- [0057] したがって、制御基板 3 からの信号の入力により F E T 4 がオンである場合、入力端子部 1 4 a から供給される電力は、第 1 導電部 2 4、第 1 導電片 5、F E T 4 のドレイン端子 4 4 及びソース端子 4 6、第 2 導電部 2 5 及び第 2 導電片 6 を介して出力側バスバー 1 5 を介して、出力端子部 1 5 a から出力される。これにより、回路構成体 1 を介して電源から負荷に電力が供給される。
- [0058] 制御基板 3 からの信号の入力により F E T 4 がオフである場合、F E T 4 のドレイン端子 4 4 及びソース端子 4 6 間は導通せず、電源から負荷への電力の供給が停止される。
- [0059] 更にサーミスタ 7 0 は、回路基板 2 の回路パターン、スルーホール 2 2、接続コネクタ 1 1 を介して制御基板 3 に接続されている。これにより、サーミスタ 7 0 が測定した温度に係る信号を制御基板 3 に入力することができる

。したがって、制御基板 3 はサーミスタ 70 からの信号に基づいて、F E T 4 が過熱しているか否かを検出できる。制御基板 3 は F E T 4 が過熱している場合、F E T 4 をオフとし、F E T 4 の過熱を防止することができる。

[0060] 上記の構成によれば、サーミスタ 70 が F E T 4 の天面に対して固定されているので、F E T 4 の周辺温度を測定する等の態様よりも F E T 4 との距離が近くなり、良好に F E T 4 の温度を測定することができる。これにより、F E T 4 の温度が上昇し、所定の閾値温度以上になった場合に F E T 4 の過熱の有無を判定できる。また、サーミスタ 70 は固着部 71 に埋設されて固定されるため、より確実に固定することができる。

[0061] 今回開示された実施形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

符号の説明

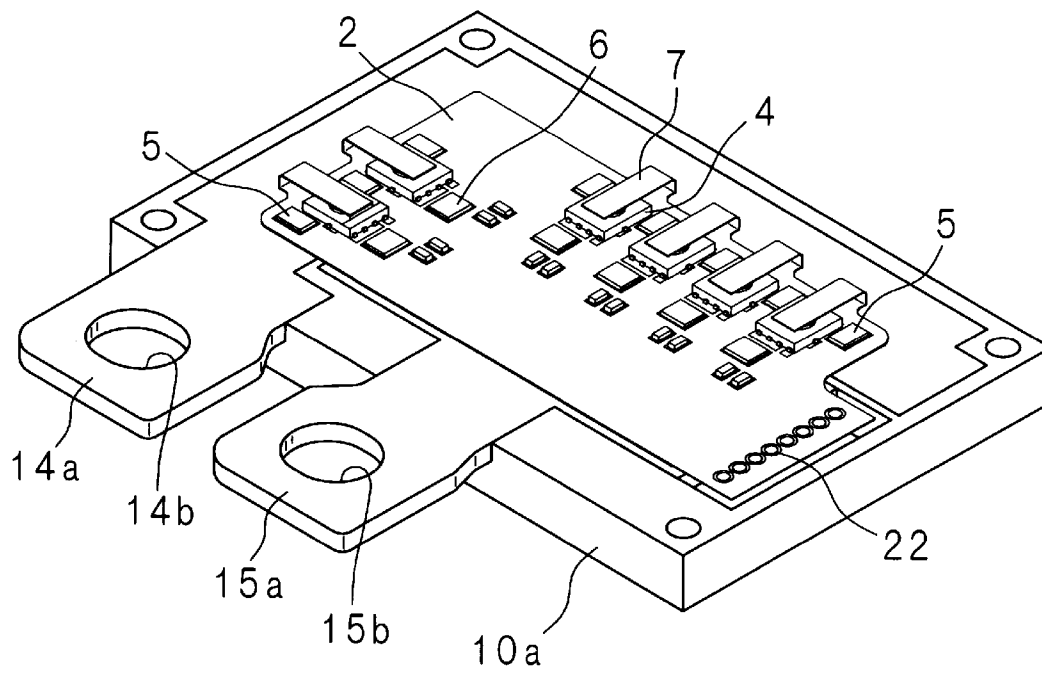
- [0062]
- | | |
|-----|---------|
| 1 | 回路構成体 |
| 10 | 筐体 |
| 10a | 本体部 |
| 10b | 蓋部 |
| 11 | 接続コネクタ |
| 12 | コネクタ |
| 12a | 端子部 |
| 14 | 入力側バスバー |
| 14a | 入力端子部 |
| 14b | 貫通孔 |
| 15 | 出力側バスバー |
| 15a | 出力端子部 |
| 15b | 貫通孔 |
| 2 | 回路基板 |

- 2 1 粘着性シート（接着シート）
- 2 1 0 第1孔
- 2 1 1 第2孔
- 2 2 スルーホール
- 2 2 a 接続部
- 2 4 第1導電部
- 2 5 第2導電部
- 2 6 ランド部
- 3 制御基板
- 4 1 第1開口部
- 4 2 第2開口部
- 4 3 第3開口部
- 4 F E T
- 4 4 ドレイン端子
- 4 5 ゲート端子
- 4 6 ソース端子
- 5 第1導電片
- 5 0 第4開口部
- 6 第2導電片
- 6 0 第5開口部
- 7 折返し部
- 7 0 サーミスタ（温度測定器）
- 7 1 固着部

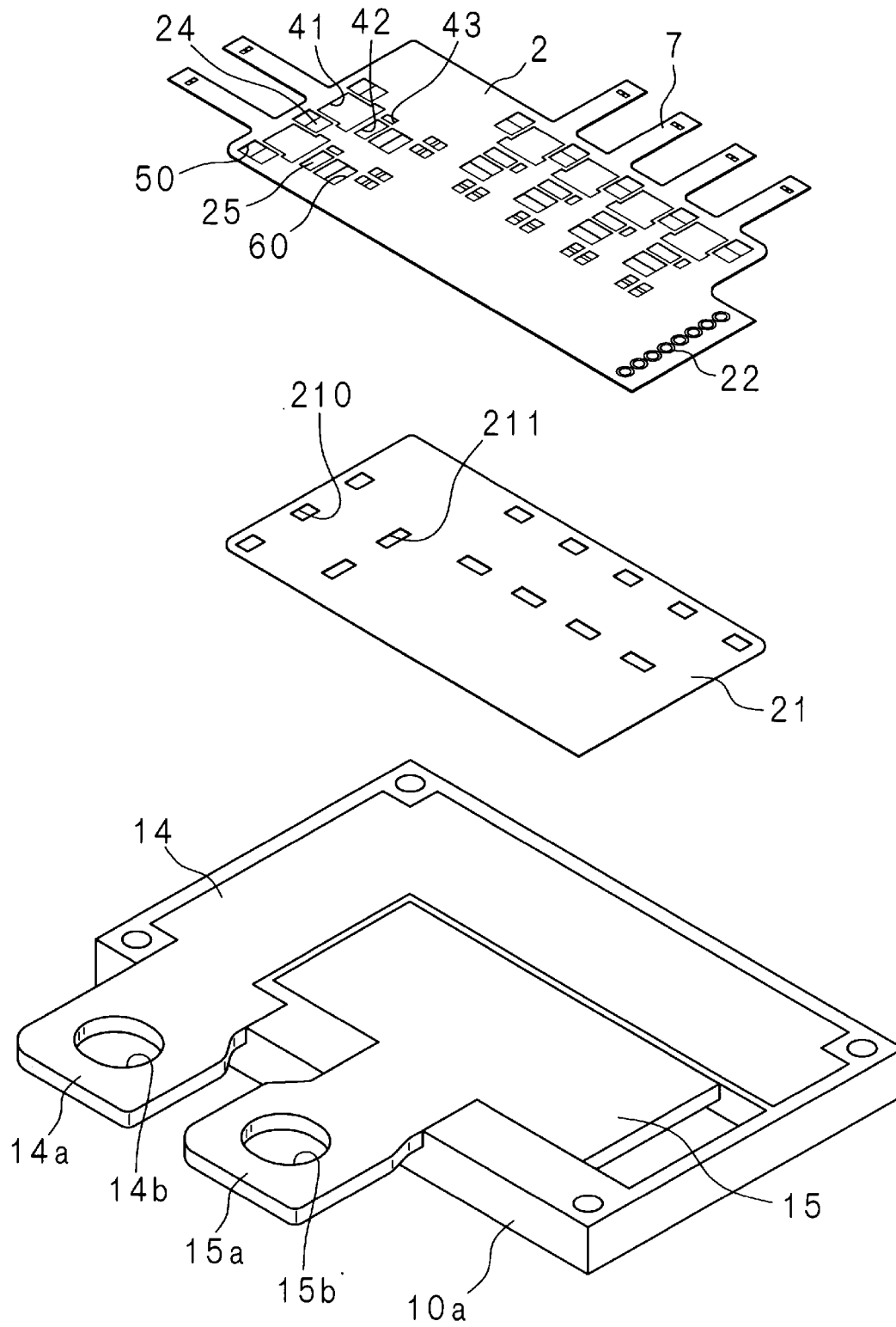
請求の範囲

- [請求項1] 回路基板と、
 該回路基板の一面に実装されているスイッチング素子と、
 前記回路基板の周縁部から延出し、前記一面側に折返している折返し部と、
 該折返し部に実装され、前記スイッチング素子に接触している温度測定器と
 を備える回路構成体。
- [請求項2] 前記スイッチング素子、折返し部及び温度測定器は夫々複数ある請求項1に記載の回路構成体。
- [請求項3] 前記温度測定器及びスイッチング素子間には固着部が設けられている請求項1又は請求項2に記載の回路構成体。
- [請求項4] 前記固着部は熱硬化性である請求項3に記載の回路構成体。
- [請求項5] 前記回路基板の他面に対向し、電力が入力される入力側バスバーと、
 前記回路基板の他面に対向し、電力が出力される出力側バスバーと
 前記回路基板に設けられ、前記スイッチング素子の入力端子及び出力端子夫々を前記入力側バスバー及び出力側バスバーに接続する導電部と
 を備える請求項1から請求項4までのいずれか一つに記載の回路構成体。

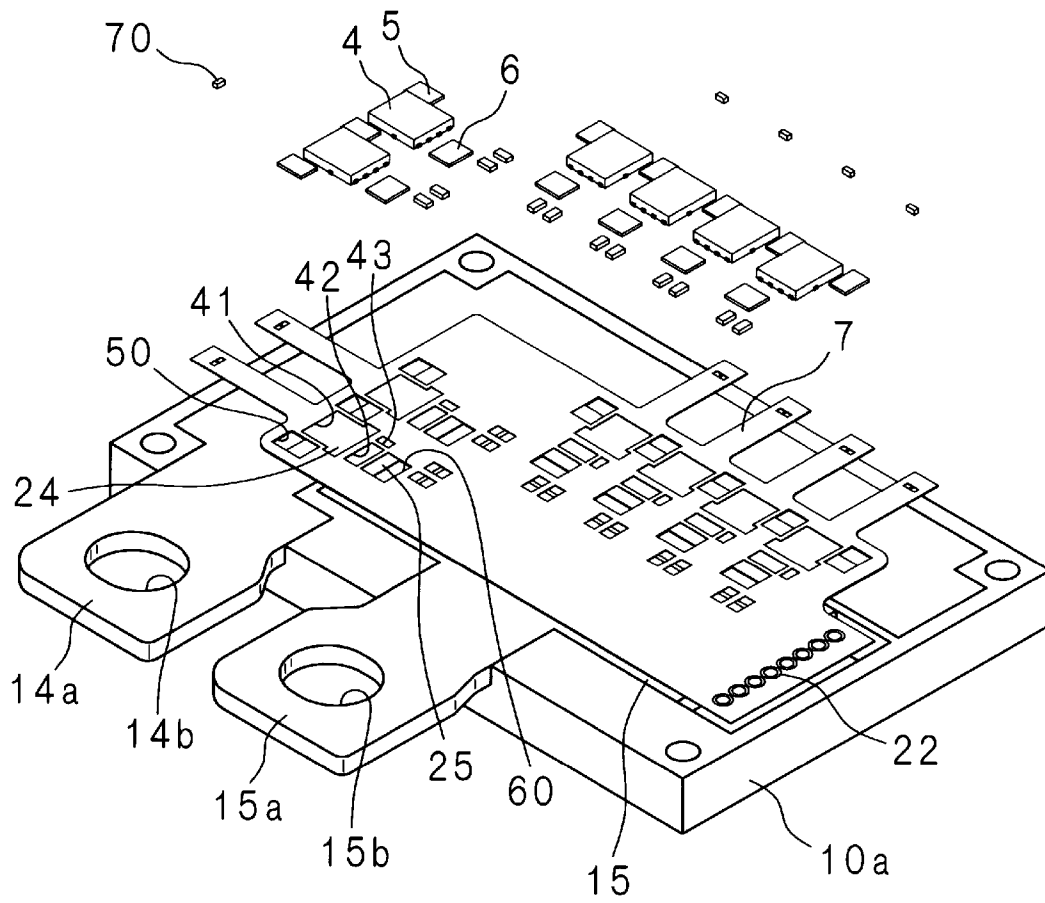
[図3]



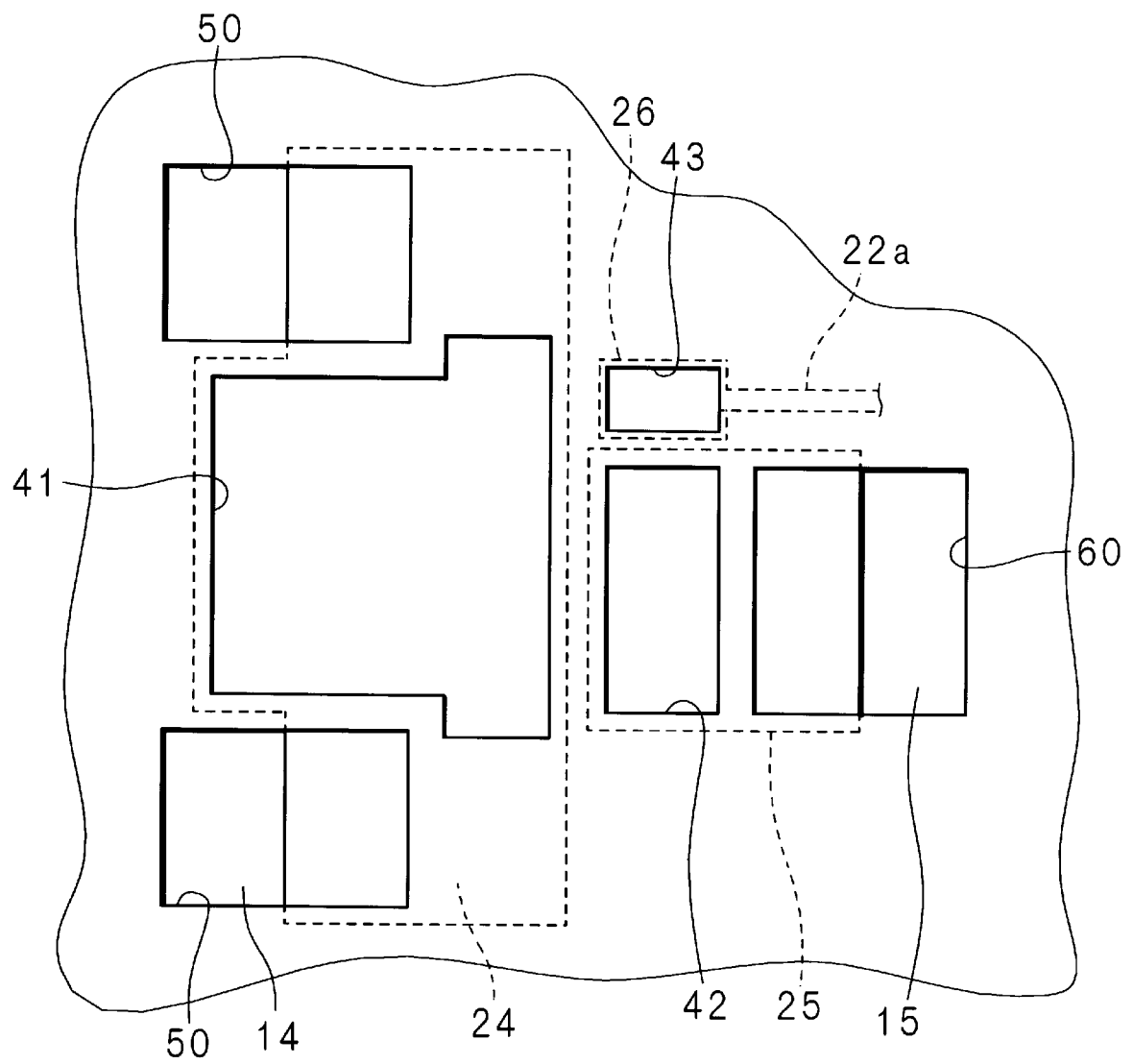
[図4]



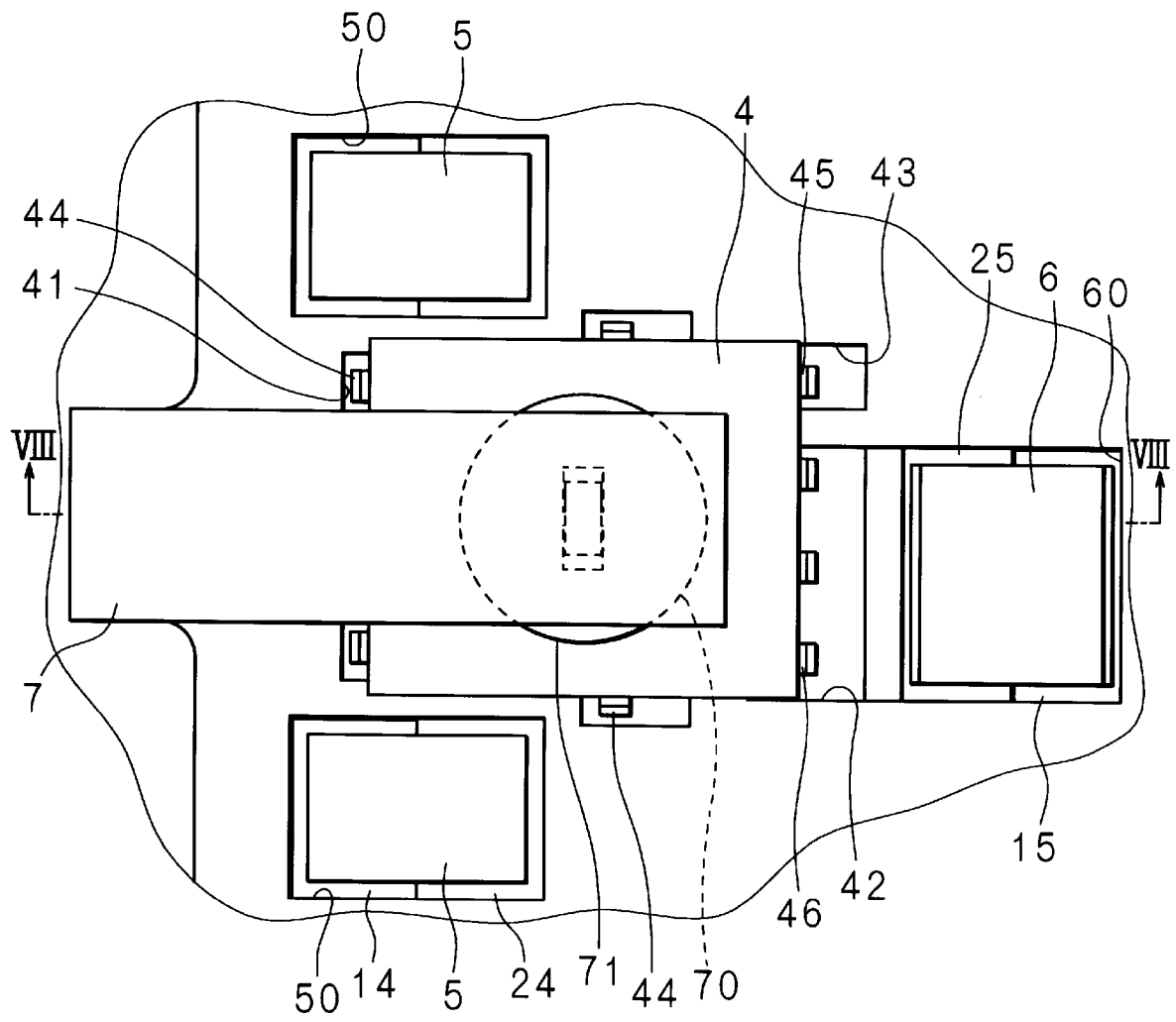
[図5]



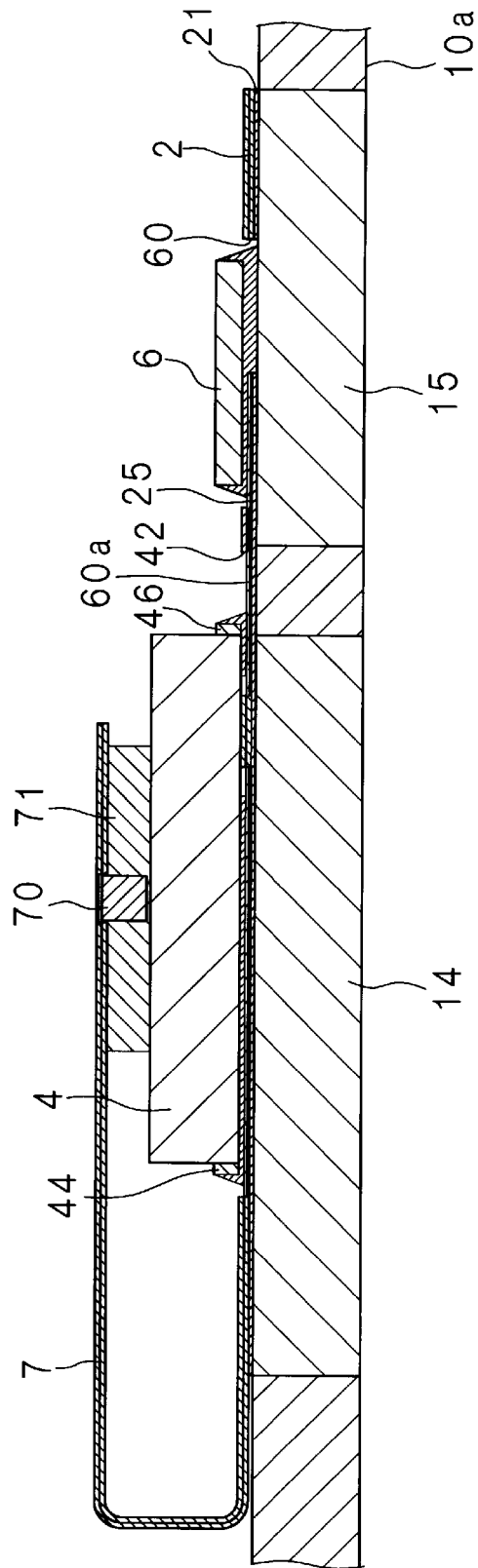
[図6]



[図7]



[図8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/027277

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H01L23/58 (2006.01) i, G01K1/14 (2006.01) i, G01K1/18 (2006.01) i, H05K7/06 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H01L23/58, G01K1/14, G01K1/18, H05K7/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2019
Registered utility model specifications of Japan	1996-2019
Published registered utility model applications of Japan	1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2001/015228 A1 (SEIKO EPSON CORPORATION) 01 March 2001, page 17, line 2 to page 18, line 1, fig. 4 & US 2004/0164396 A1, paragraphs [0173]-[0177], fig. 4 & TW 567561 B	1-5
Y	JP 9-289281 A (KOKUSAI ELECTRIC CO., LTD.) 04 November 1997, paragraphs [0017]-[0023] (Family: none)	1-5

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 19.08.2019	Date of mailing of the international search report 27.08.2019
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/027277

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2004-253759 A (AUTONETWORKS TECHNOLOGIES LTD.) 09 September 2004, paragraphs [0028]-[0074], fig. 4 & US 2004/0190272 A1, paragraphs [0046]-[0055], fig. 4	5

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01L23/58(2006.01)i, G01K1/14(2006.01)i, G01K1/18(2006.01)i, H05K7/06(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01L23/58, G01K1/14, G01K1/18, H05K7/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2019年
日本国実用新案登録公報	1996-2019年
日本国登録実用新案公報	1994-2019年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	WO 2001/015228 A1 (セイコーエプソン株式会社) 2001.03.01, 第17頁第2行-第18頁第1行, FIG. 4 & US 2004/0164396 A1, [0173]-[0177], FIG. 4 & TW 567561 B	1-5
Y	JP 9-289281 A (国際電気株式会社) 1997.11.04, [0017]-[0023] (ファミリーなし)	1-5

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

19.08.2019

国際調査報告の発送日

27.08.2019

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

河合 俊英

5 F

3238

電話番号 03-3581-1101 内線 3516

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2004-253759 A (株式会社オートネットワーク技術研究所) 2004.09.09, [0028]-[0074], [図 4] & US 2004/0190272 A1, [0046]-[0055], FIG. 4	5